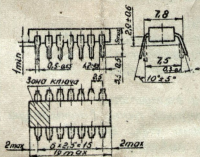
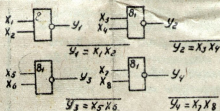


Технические условия БКО.348.006ТУ
Функциональное назначение - четыре
логических элемента "И-НЕ"



Вес микросхемы не более 1г



Выход	Назначение
1	Вход X ₁
2	Вход X ₂
3	Выход Y ₁
4	Вход X ₃
5	Вход X ₄
6	Выход Y ₂
7	Общий
8	Выход Y ₃
9	Вход X ₅
10	Вход X ₆
11	Выход Y ₄
12	Вход X ₇
13	Вход X ₈
14	Питание E

Напряжение питания $E = +5\text{В} \pm 5\%$
Содержание золота в одной микросхеме 0,0055575г
Электрические параметры при температуре $+20 \pm 5^\circ\text{C}$

Наименование	Нормы
Нагрузочная способность, N	10
Время задержки выключения t_3^{01} , нсек, не более	22
Время задержки включения t_3^{10} , нсек, не более	15
Выходное напряжение, лог. "1" $U_{\text{вых}}$, не более	0,4
Выходное напряжение, лог. "0" $U_{\text{вых}}$, в, не более	2,4

Предельно-допустимые условия эксплуатации.

Диапазон рабочей температуры от минус 10 до +70°C.

Предельно-допустимое кратковременное напряжение питания составляет 76 в течение времени 5 миллисекунд.

Срок хранения - 12 лет.

Время гарантийной наработки

гарантируется соответствие микросхемы требованиям частных технических условий при наработке 1000 часов.

Гарантии исчисляются со дня отгрузки микросхем потребителю.

Указания и рекомендации по эксплуатации.

Крепление микросхемы к печатной плате в аппаратуре может быть произведено методом пайки выводов.

Расстояние от места пайки вывода до корпуса микросхемы должно быть не менее 2,5 мм. Пайку следует производить

с принятым мер исключающих повреждение микросхемы из-за перегрева и механических усилий. При пайке рекомендуется применять припой ПОС-61 ГОСТ 1499-70 флюс ФКСп НО 054.083.

При пайке с помощью паяльника последний должен быть обязательно заземлен и иметь мощность не более 60 Вт. При пайке температуры не должна превышать 260°C, а время воздействия этой температуры на микросхему не более 5 сек.

При монтаже руководствоваться указаниями: черт. А.308, 078 ГЧ.

После монтажа микросхема должна быть защищена в соответствии с нормалью НО 054.024. С целью повышения надежности аппаратуры рекомендуется принимать меры, обеспечивающие минимальную температуру нагрева корпуса микросхем и защиту от воздействия климатических факторов. При ремонте аппаратуры смену микросхем необходимо производить только при отключенных источниках питания.

Дата выпуска
Штамп ОТК



30/VII-742. Заказ №